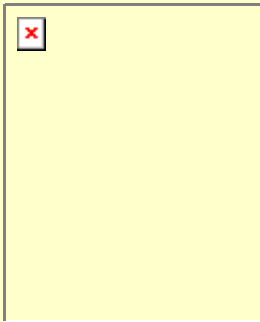


## 本期封面



2003年12期

栏目:

DOI:

论文题目: 板坯连铸结晶器热流量分布的研究

作者姓名: 张炯明, 张立, 王新华, 王立峰

工作单位: 北京科技大学冶金与生态工程学院, 北京 100083

通信作者: 张炯明

通信作者Email: [Jmz203@sina.com](mailto:Jmz203@sina.com)

文章摘要: 利用结晶器拉漏预报的热电偶所测的结晶器铜板的温度, 采用数值模拟方法对连铸结晶器壁画的热流量进行了计算. 详细给出不同工艺情况下, 结晶器壁铜板温度及瞬时热流量的分布, 并在此基础上对渣圈厚度进行了计算, 详细分析了连铸工艺参数对结晶器铜墙铁壁板温度、瞬时热流量及渣圈厚度的影响.

关键词: 数学模型, 瞬时热流量, 铜板温度, 渣圈厚度

分类号: TG249.7

关闭